

# R-IN32M3-EC/CL

R18AN0039JJ0126

Rev.1.26

R-IN32M3-EC/CL CC-Link ドライバ/ミドルウェア リリースノート

2018.12.27

## 要旨

この資料は、本製品のパッケージ内容、動作環境について記載しております。ご使用前に、必ずお読みいただきますようお願い申し上げます。

なお、各サンプルソフトウェア、ミドルウェア等の使用方法につきましては、下記の関連ドキュメントを合わせてご参照ください。

## 関連ドキュメント

R18UZ0002JJ****	R-IN32M3-EC ユーザーズ・マニュアル
R18UZ0004JJ****	R-IN32M3-CL ユーザーズ・マニュアル
R18UZ0023JJ****	R-IN32M3-CL 開発ツール スタートアップ・マニュアル
R18UZ0010JJ****	R-IN32M3 シリーズ プログラミング・マニュアル OS 編
R18UZ0020JJ****	R-IN32M3 シリーズ ボード設計編
R18UZ0008JJ****	R-IN32M3 シリーズ プログラミング・マニュアル ドライバ編
R18UZ0006JJ****	R-IN32M3 シリーズ ユーザーズ・マニュアル 周辺機能編
R18UZ0055JJ***	R-IN32 シリーズ ユーザーズ・マニュアル CC-Link リモートデバイス局編

上記資料番号の末尾\*\*\*\*部分は版数です。当社ホームページより最新版をダウンロードしてご参照ください。

## 目次

1. はじめに.....	2
2. パッケージ内容 .....	2
3. フォルダ構成.....	2
4. 動作環境.....	3
5. ホームページとサポート窓口 .....	4

## 1. はじめに

R-IN32M3-EC/-CL用 CC-Link リモートデバイス局 パッケージは、R-IN32M3- EC/-CLを使用した CC-Link リモートデバイス局 Ver1, Ver2 のサンプルアプリケーションを纏めたソフトウェアパッケージです。本パッケージはドライバ・ミドルウェアパッケージと組み合わせて使用します。ドライバ・ミドルウェア の ¥Project 下へ本パッケージの CCSV1/CCSV2 を移してご使用下さい。

## 2. パッケージ内容

本パッケージに含まれるサンプルアプリケーション、ライブラリ、ミドルウェア、周辺機能ドライバを以下に示します。

- ・サンプルアプリケーション

No.	サンプルアプリケーション名
1	CC-Link Ver.1 for sample application
2	CC-Link Ver.2 for sample application

## 3. フォルダ構成

本パッケージのフォルダ構成を以下に示します。

TOP

|

├─ CCSV1    ── CC-Link Version 1

|    ── readme.txt

|    ── ARM

|    ── GCC

|    ── GX\_works2 【GX Works2 用サンプルプロジェクト・ファイル】

|    ── IAR

|

├─ CCSV2    ── CC-Link version 2

    ── readme.txt

    ── ARM

    ── GCC

    ── GX\_works2 【GX Works2 用サンプルプロジェクト・ファイル】

    ── IAR

#### 4. 動作環境

本パッケージの動作環境を以下に示します。

- 対象デバイス
  - R-IN32M3-CL
  - R-IN32M3-EC
  
- ターゲットボード
  - テセラ社製 R-IN32M3-EC 評価キット (TS-R-IN32M3-EC)
  - テセラ社製 R-IN32M3-CL 評価キット (TS-R-IN32M3-CL)
  
- 開発環境
  - コンパイラ
    - IAR 社製 Embedded Workbench for ARM 7.80
  - デバッガ
    - IAR 社製 Embedded Workbench for ARM 7.80
  - ICE
    - IAR 社製 I-jet / JTAGjet-Trace

## 5. ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/contact/>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 変更履歴

バージョン	変更内容
V1.2.6 (2018/11/19)	<p>[Changed]</p> <p>/CCSV1/main.c /CCSV2/main.c</p> <p>- IOTENSU changed to low fixed. "Number of I/O points fixed to 32 points" can not be used.</p>
V1.2.5 (2017/12/12)	<p>[Add]</p> <p>- Added RUN LED on / off control by master station version. - RUN LED off when the master station is Ver.1 - RUN LED on when the master station is other than Ver.1 - RUN LED turns off when communication timeout occurs.</p> <p>- Added initialization port setting for RUN LED control.</p>
V1.2.4 (2015/11/30)	<p>The following type name of products correspond with "Revision 2" and the other type name of products with "Revision 1"</p> <p>- Revision 2 R-IN32M3-EC : MC-10287BF1-HN4-M1-A / MC-10287BF1-HN4-A R-IN32M3-CL : UPD60510BF1-HN4-A / UPD60510BF1-HN4-M1-A</p> <p>[Changed]</p> <p>/CCSV1/IAR/boot_norflash.icf /CCSV1/IAR/boot_serialflash.icf /CCSV1/IAR/iram.icf /CCSV1/ARM/scat_boot_extrom.ld /CCSV1/ARM/scat_boot_iram.ld /CCSV1/ARM/scat_boot_sflash.ld /CCSV1/GCC/scat_boot_extrom.ld /CCSV1/GCC/scat_boot_iram.ld /CCSV1/GCC/scat_boot_sflash.ld</p> <p>/CCSV2/IAR/boot_norflash.icf /CCSV2/IAR/boot_serialflash.icf /CCSV2/IAR/iram.icf /CCSV2/ARM/scat_boot_extrom.ld /CCSV2/ARM/scat_boot_iram.ld /CCSV2/ARM/scat_boot_sflash.ld /CCSV2/GCC/scat_boot_extrom.ld /CCSV2/GCC/scat_boot_iram.ld /CCSV2/GCC/scat_boot_sflash.ld</p> <p>There are two types of mapping files and startup routine in this sample software. One is for "Revision 1" (CPU access area limitation *notice) The other is for "Revision 1" (no limitation)</p> <p>Mapping file(*.ld) and startup routine (startup_RIN32M3.c) for ARM are updated. Before: The common area is assigned for stack and Heap. After: Dedicated area is assigned for Heap. Especially GCC, please use mapping file and startup routine for same Revision.</p> <p>Mapping file for Revision 1 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/IAR/rev1 r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/GCC/rev1</p>

	<p>r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/ARM/rev1</p> <p>Mapping file for Revision 2  r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/IAR/rev2  r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/GCC/rev2  r-in32m3_samplesoft/Device/Renesas/RIN32M3/Source/Templates/ARM/rev2</p> <p>*notice Please refer below documentation  <a href="http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/tu/tnrina001be.pdf">http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/tu/tnrina001be.pdf</a></p>
V1.2.3 (2015/8/31)	<p>[Changed]  /CCSV1/GCC/scat_boot_iram.ld  /CCSV2/GCC/scat_boot_iram.ld</p> <p>- Remove unnecessary definition of linker file.</p>
V1.2.2 (2015/5/19)	<p>[Changed]  - Update EWARM project file and makefiles.  - Change the processing of timeout setting function.  - "RIN32M3_CL" is defined.</p>
V1.2.1 (2015/2/13)	<p>[Add]  - Add port setting for R-IN32M3-EC Evaluation Board.  - Add sample code for bidirectional communication.</p> <p>[Changed]  - Change interrupt port to INTPZ7 in CCSV2.</p>
V1.2.0 (2015/1/23)	<p>[Changed]  Correspondence of Conformance Test  - Additional application buffer  - Disable loopback function (initial state)</p>
V1.1.0 (2014/1/16)	<p>[Fixed]  - Fix how to monitor INTPZ1 pin in CCSV2.  - Fix port control for RS-485 transceiver.</p> <p>[Changed]  - Update EWARM project file and makefiles.  - Delete CC-Link IE WDT disable sequence.  - Port setting sequences.</p>
V1.0.0 (2016/1/29)	<p>First release</p>

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。

CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。

### 2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。

外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

【注意】リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。

リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子

（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。

同じグループのマイコンでも型名が違っていると、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が異なる製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

- Arm<sup>®</sup> および Cortex<sup>®</sup> は、Arm Limited (またはその子会社) の EU またはその他の国における登録商標です。 All rights reserved.
- Ethernet およびイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- IEEE は、the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の登録商標です。
- TRON は” The Real-time Operation system Nucleus” の略称です。
- ITRON は” Industrial TRON” の略称です。
- $\mu$ ITRON は” Micro Industrial TRON” の略称です。
- TRON、ITRON、および $\mu$ ITRON は、特定の商品ないし商品群を指す名称ではありません。
- CC-Link 及び CC-Link IE Field は、CC-Link 協会 (CC-Link Partner Association:CLPA) の登録商標です。
- その他、本資料中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。



## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
  3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
  4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、  
家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、  
金融端末基幹システム、各種安全制御装置等  
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。
  6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
  11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)



■営業お問合せ窓口

<http://www.renesas.com>

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。  
総合お問合せ窓口：<https://www.renesas.com/contact>